

高速通信向け銅張積層板 エスパネックス / ESPANEX® (次世代低誘電CCL)

開発品 低誘電グレード

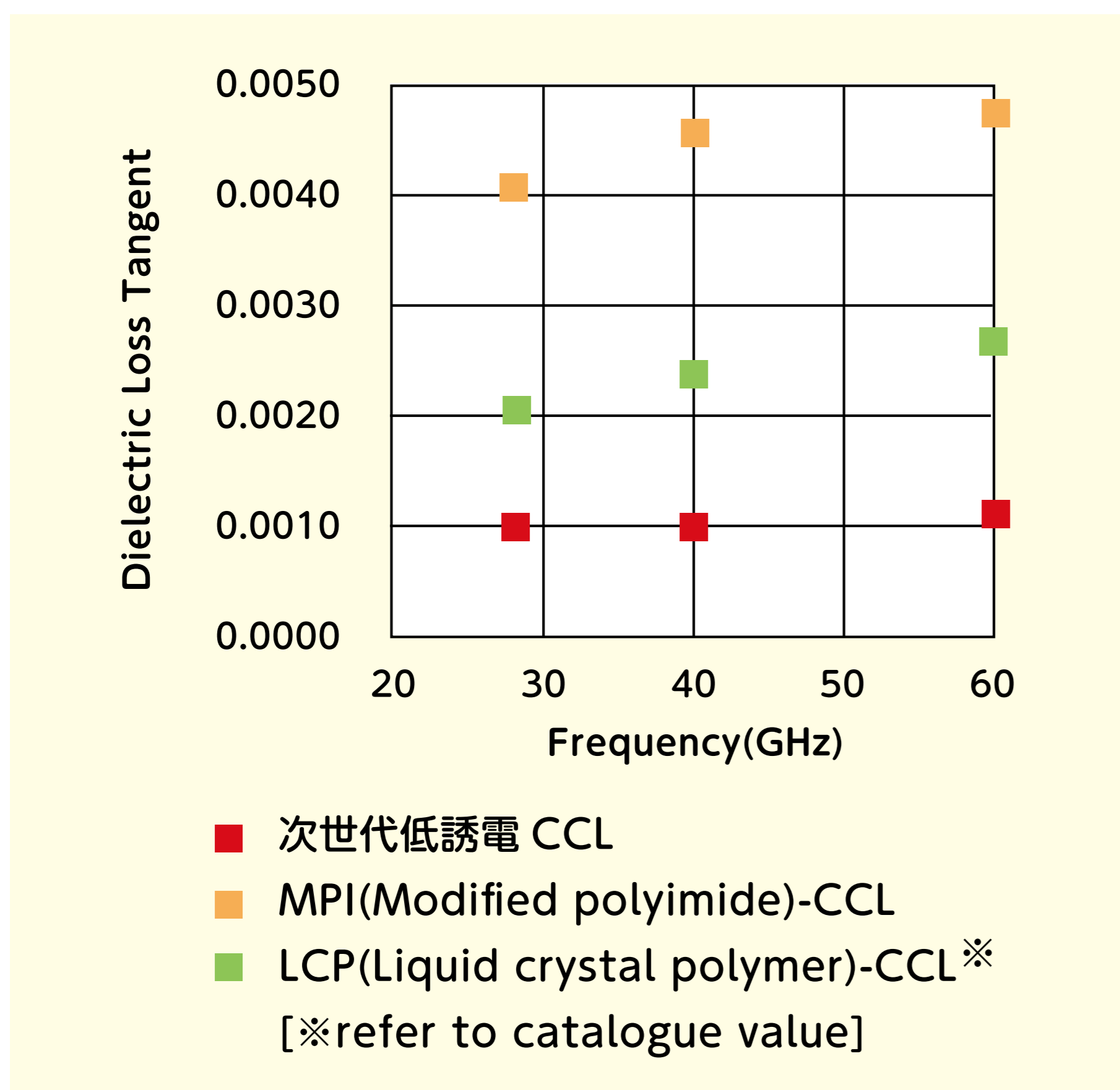
特長

- ▶ 高周波帯域において、低誘電特性を示す。
 - ▶ 低粗度銅箔に対し、高い接着力を発現する。
- ⇒ 5G ミリ波での高速通信において、フッ素樹脂基板と同等の低伝送損失を実現。

一般特性 (プロトタイプ)

Properties (Prototype)		
Dielectric Constant [X-Y(面方向)]	28GHz	2.8
	40GHz	2.8
	60GHz	2.8
Dielectric Loss Tangent [X-Y(面方向)]	28GHz	0.0010
	40GHz	0.0010
	60GHz	0.0011
Peel Strength [kN/m]		1.0
Water Absorption [wt%]		≤ 0.1
Solder Heat Proof		288°C Pass

誘電特性



伝送特性 (シミュレーション)

